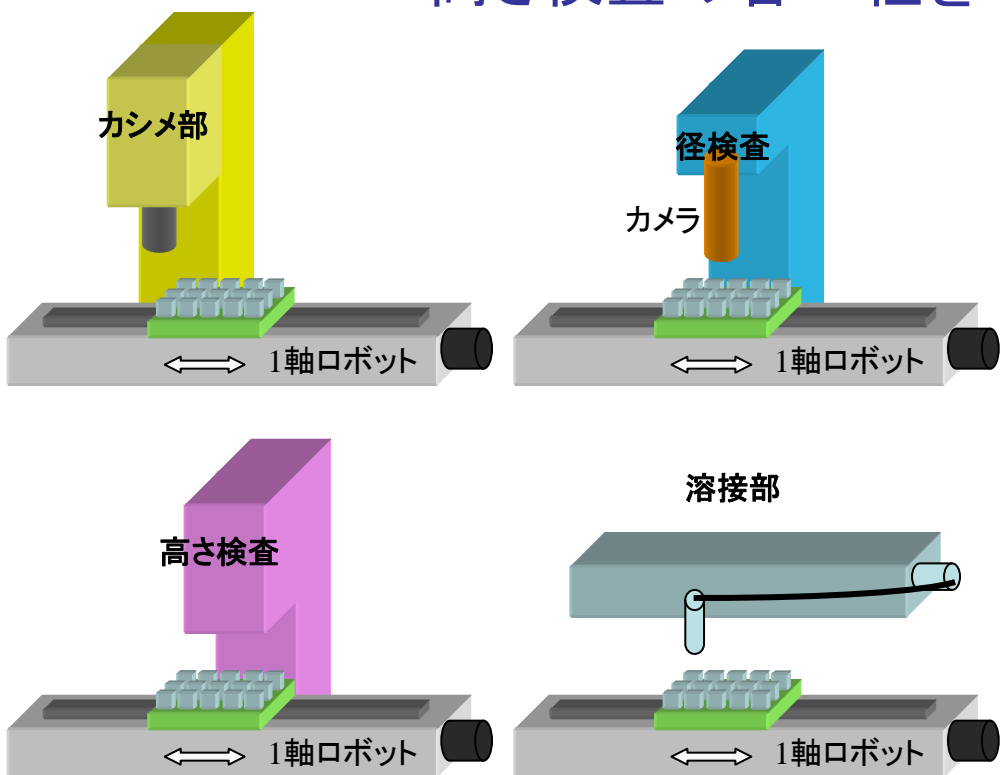


## 装置概要

微小電子部品製造においてリベットカシメ、レーザスポット溶接、リベットカシメ径検査およびリベットカシメ高さ検査の各工程を半自動にて行います。



## 特徴:

1. 各加工、検査工程で使用する治具(ワーク27個搭載)の共用化を実現
2. 1軸ロボット使用によるワーク位置決めの高精度化、高速化を実現

## 装置:

1. 位置及び圧力管理の容易なサーボプレスを使用
2. 最小径 $\Phi 0.6\text{mm}$ のレーザスポット溶接
3. 画像処理による非接触カシメ径検査
4. 高精度センサによるカシメ高さ検査

## 応用分野:

微小電子部品のカシメ、レーザ溶接